

Title (en)

DEVICE FOR APPLYING ADHESIVE ONTO PREDOMINANTLY FLAT MATERIAL CUTS

Title (de)

VORRICHTUNG ZUM AUFTRAGEN VON KLEBSTOFF AUF VORWIEGEND FLÄCHIGE MATERIALZUSCHNITTE

Title (fr)

DISPOSITIF D'APPLICATION DE COLLE SUR DES SECTIONS DE MATÉRIAU ESSENTIELLEMENT PLATES

Publication

EP 3248772 A1 20171129 (DE)

Application

EP 17000752 A 20170503

Priority

DE 102016006504 A 20160528

Abstract (en)

[origin: CN107433731A] The invention relates to a gluing device for the linear application of adhesive to grooved cardboard blanks, with an application nozzle which can be moved in a straight line over the cardboard resting in the processing position, wherein the distance between the application nozzle and the cardboard blank is determined by a support roller attached to the nozzle receptacle.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft eine Beleimvorrichtung für den linienförmigen Auftrag von Klebstoff auf genutete Pappenzuschnitte, mit einer über die in der Bearbeitungsposition ruhende Pappe geradlinig bewegbaren Auftragsdüse, wobei der Abstand der Auftragsdüse zu dem Pappenzuschnitt durch eine an der Düsenaufnahme befestigte Stützrolle festgelegt ist.

IPC 8 full level

B31B 50/62 (2017.01)

CPC (source: EP)

B31B 50/624 (2017.07)

Citation (applicant)

WO 2013110986 A1 20130801 - EMMECI SPA [IT]

Citation (search report)

- [IA] US 4368052 A 19830111 - BITSKY THOMAS C, et al
- [A] WO 2005075185 A1 20050818 - NAGAI HAJIME [JP]
- [A] US 2006081727 A1 20060420 - STEPANIAK JUDE A [US], et al

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

EP 3248772 A1 20171129; EP 3248772 B1 20190227; CN 107433731 A 20171205; CN 107433731 B 20200811;
DE 102016006504 A1 20171214

DOCDB simple family (application)

EP 17000752 A 20170503; CN 201710327707 A 20170511; DE 102016006504 A 20160528